

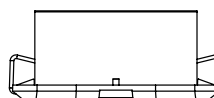


# High Performance BGA Cooling Solutions w/ maxiGRIP™ Attachment

**ATS PART # ATS-53190R-C2-R0**

## Features & Benefits

- » High aspect ratio, straight fin heat sinks that are ideal for compact PCB environments
- » maxiGRIP™ attachment applies steady, even pressure to the component and does not require holes in the PCB
- » Designed specifically for BGAs and other surface mount packages
- » Meets Telcordia GR-63-Core Office Vibration; ETSI 300 019 Transportation Vibration; and MIL-STD-810 Shock Testing and Unpackaged Drop Testing standards
- » Comes preassembled with high performance, phase changing, thermal interface material



*\*Image above is for illustration purposes only.*

## Thermal Performance

| AIR VELOCITY |     | THERMAL RESISTANCE   |                    |
|--------------|-----|----------------------|--------------------|
| FT/MIN       | M/S | °C/W (UNDUCTED FLOW) | °C/W (DUCTED FLOW) |
| 200          | 1.0 | 8.4                  | 5.3                |
| 300          | 1.5 | 6.8                  |                    |
| 400          | 2.0 | 5.9                  |                    |
| 500          | 2.5 | 5.3                  |                    |
| 600          | 3.0 | 4.9                  |                    |
| 700          | 3.5 | 4.5                  |                    |
| 800          | 4.0 | 4.3                  |                    |

## Product Details

| DIMENSION A | DIMENSION B | DIMENSION C | DIMENSION D | INTERFACE MATERIAL  | FINISH         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|
| 19 mm       | 19 mm       | 19.5 mm     | 19 mm       | SAINT-GOBAIN C1100F | BLACK-ANODIZED |

### NOTES:

- 1) Dimension C = heat sink height from bottom of the base to the top of the fin field.
- 2) ATS-53190R-C1-R0 is a substitute item available utilizing an equivalent phase change material (Chomerics T766).
- 3) Thermal performance data are provided for reference only. Actual performance may vary by application.
- 4) ATS reserves the right to update or change its products without notice to improve the design or performance.
- 5) Optional maxiGRIP™ Installation/Removal Tool Set P/N: MGT190
- 6) Contact ATS to learn about custom options available.



**ATS** ADVANCED  
THERMAL  
SOLUTIONS, INC.  
Innovations in Thermal Management®

**For more information, to find a distributor or to place an order, visit [www.qats.com](http://www.qats.com) or call: 781.769.2800 (North America); +31 (0) 3569 84715 (Europe).**

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9